



连接器 > 接口插槽 > 内存插槽 > SO DIMM 插槽



DRAM 类型: 双倍数据速率 (DDR) 3

堆叠高度: 5.2 mm [.205 in]

模块方向: 直角

位数: 204

中心线 (间距) : .6 mm [.024 in]

产品特性

产品类型特性

| | |
|-----------|----------------|
| 连接器系统 | 缆到板 |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| DRAM 类型 | 双倍数据速率 (DDR) 3 |

结构特性

| | |
|------|-----|
| 托架数 | 2 |
| 钥匙数 | 1 |
| 行数 | 2 |
| 模块方向 | 直角 |
| 位数 | 204 |

电气特征

| | |
|---------|-------|
| DRAM 电压 | 1.5 V |
|---------|-------|

信号特征

| | |
|----------|-------|
| SGRAM 电压 | 1.5 V |
|----------|-------|

主体特性

| | |
|--------|-------|
| 弹射器位置 | 两端 |
| 插销材料 | 不锈钢 |
| 插销电镀材料 | 锡 |
| 模块钥匙类型 | SGRAM |
| 弹射器类型 | 锁定 |
| 连接器外形 | 反向 |

接触件特性

| | |
|----------------|------|
| 内存插槽类型 | 内存卡 |
| PCB 端子端接区域电镀材料 | 金 |
| 端子基材 | 铜合金 |
| 端子额定电流 (最大值) | .5 A |
| 端子接触部电镀材料 | 镀金 |

端接特性

| | |
|----------|------|
| 插入种类 | 凸轮 |
| PCB 端接方法 | 表面贴装 |

机械附件

| | |
|------------|------|
| 接合对准类型 | 反向键控 |
| PCB 安装固定 | 带有 |
| PCB 安装固定类型 | 焊钉 |
| 连接器安装类型 | 板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|-----------------|
| 外壳材料 | 高温热塑塑料 |
| 壳体颜色 | 黑色 |
| 中心线 (间距) | .6 mm [.024 in] |

尺寸

| | |
|------|------------------|
| 堆叠高度 | 5.2 mm [.205 in] |
| 行间距 | 8.2 mm [.322 in] |

使用环境

| | |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 85 °C [-67 – 185 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

| | |
|------|----|
| 电路应用 | 电源 |
|------|----|

行业标准

| | |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

| | |
|------|----------------|
| 封装数量 | 200 |
| 封装方法 | Emboss on Reel |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | RAYCHEM RVS



RJ45 连接器(1)



SD 卡连接器(2)

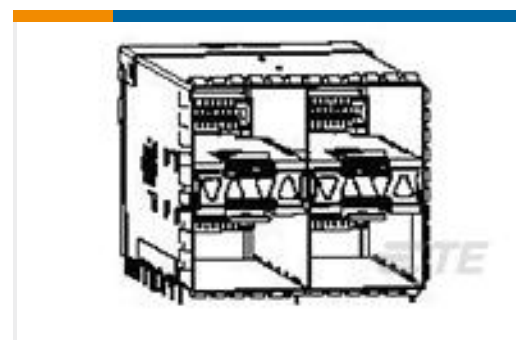
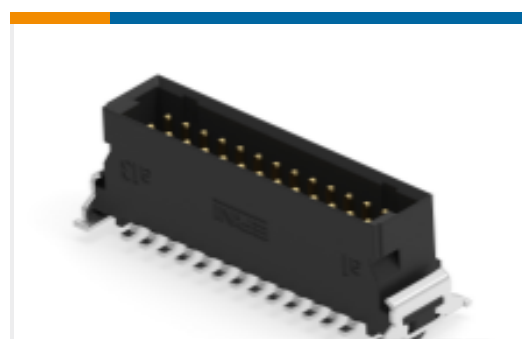
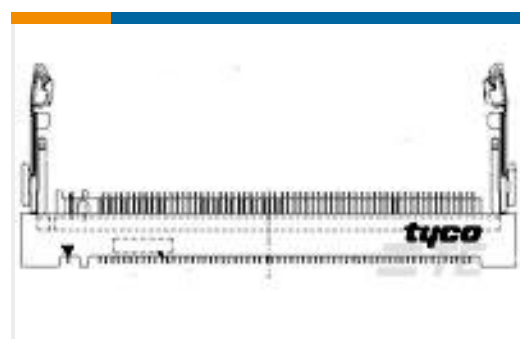


SO DIMM 插槽(13)



接头和拼接件(4)

客户还购买了

TE 产品编号1-338311-2
25POS.HD20 PLUG ASSTE 产品编号1857994-1
Z-PACK/A F-HDR 110P, EONTE 产品编号2198325-6
zSFP+ STACKED 2X2 RECEPTACLE
ASSEMBLYTE 产品编号2309412-3
DDR4 SODIMM 260P 8.0H RVS
ASSEMBLYTE 产品编号2-2013022-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 4H STDTE 产品编号5223961-1
TE UPM R/A Header 3P STD Power,
LLLTE 产品编号3-6318490-6
.5FHR04H,220,S,GIG,08/Sn,HT,NSYesTE 产品编号8-1879336-4
CPF 0603 1K69 1% 50PPM 1K RLTE 产品编号244837-E
SMCQ 26 M AB VV 8-13 CL * H007 137
E005TE 产品编号1717831-1
MINI PCI EXPRESS SEMI HARD TRAY
CONN

文档

产品图纸

[EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H RVS](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2013290-1_B_c-2-2013290-1-b.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2013290-1_B_c-2-2013290-1-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2013290-1_B_c-2-2013290-1-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[DDR3 DIMM Sockets Flyer 6-1773454-7 05/09](#)

英文版本

产品规格

[产品规格](#)

英文版本